

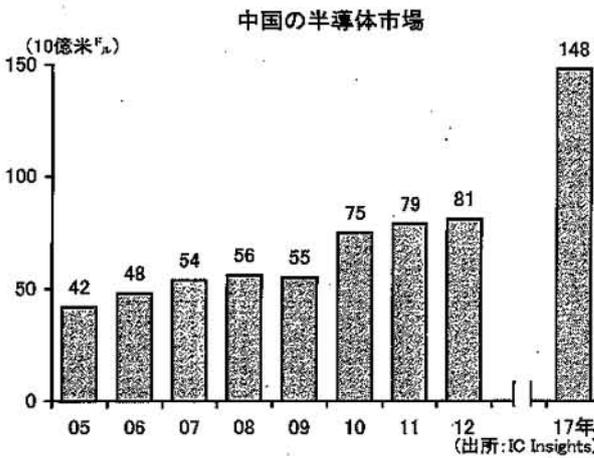
セミコンチャイナ2013

先端半導体装置・材料一堂に

成長著しい中国市場に照準

【上海＝猪狩特派員】半導体産業をけん引してきたパソコンが成熟し、スマホや携帯端末機などの新しいアプリケーションがその座をうかがう。主要ユーザーの大半がアジアにあるいま、中国の動きが今後の方向を決めるともいえる。先端半導体装置・材料の日本、欧米、台湾など、主要メーカーはどうか対応しようとしているのか。19日から開催中の「セミコンチャイナ2013」で、その動きが注目される。

WSTSによれば、12年平均成長率13%で拡大。17年の世界半導体市場は、28年には、1480億ドルに達すると予測する。世界半導体市場規模は3893億ドルが予測され、そのうち38%を中国が占めることになる。一方、中国市場は米国調査会社IC Insightsによれば、12年度810億ドル(前年比2.5%増)。17年には、年平均



その中で開催された「セミコンチャイナ2013」では、日系、欧米、台湾などの装置・材料主要メーカーの取り組みはどのようなか、それらがどうなるかを内容に心が集まる。主要日系メーカーをまとめる。

ナノテク製品を紹介する。アドバンテストは、中国半導体市場の発展を同社のR&D技術力が支えてきた背景をベースに、新たにナ

ノテクノロジー専門の製品の紹介。電子ビームを用いた露光装置「F7000」と多次元顕微鏡・側長走査型電子顕微鏡、ウエハ用MV MISEM「E3310」を紹介する。いずれも同社の中期計画の柱の一つである。

研究開発から量産まで幅広いレンジ市場を狙う戦略の一環とする取り組みである。IT革命の爆発を担う半導体の高集積化・微細化が

「SEM770」を提案する。従来、落下強度とヒートサイクルなどの耐久性を両立する要求が高かったが、スズ(Sn)・銀(Ag)・銅(Cu)の組成を最適化することで両立に成功。また、実装用途には「銅核ボ

三次元回路形成は、東京エレクトロンは、50年間にわたり、同社のもつ半導体技術で未来の世界を開いてきた実績を強調。先端技術として、三次元回路形成、ダブルパターンニング、自己組織化などの技術を紹介します。

また、ユーザーの持つコアツールをベースに用途に応じたラインを組みあわせる「フィールド・ソリューション」を提案し、低コストで信頼性のあるプロセスを実現する。

千住金属工業は、実装用のはんだ材料として、ハロゲンフリーなどの環境規制に対応するべく、最先端の性能を提供する技術を紹介する。同社のもつ開発力を強調することで存在感を出す。今回新製品として

機械装置センター材料中心にローエンドからハイエンドまで多様なユーザーニーズに対応する。今回の展示では、中国のサブコンに向けられたLSV材料紹介を主とする。最近はこの領域も含め、韓国材料メーカーの動きも活発化しているという。



先端半導体装置・材料の動きに注目が集まる「セミコンチャイナ2013」

進み、20nm以下のプロセスのストリームラインを提示する。

「SEM770」を提案する。従来、落下強度とヒートサイクルなどの耐久性を両立する要求が高かったが、スズ(Sn)・銀(Ag)・銅(Cu)の組成を最適化することで両立に成功。また、実装用途には「銅核ボ